

Nos mousses thermiques également appelées Gap Pad ou Gap Filler sont des matériaux thermo-conducteurs à base de silicone qui résolvent les problèmes de dissipation de chaleur. Le TGF-066-AB est un matelas spécialement conçu pour les applications nécessitant un refroidissement moyen. En effet, c'est un excellent conducteur thermique de 6.5W/mK, avec une bonne résistance thermique facilitant ainsi le transfert de chaleur et possède également une excellente isolation électrique. En dessous de 1mm, le matelas est difficile à utiliser en pick-in-place pour la production robotique, dans ce cas il faudra prévoir un réglage de sa dureté avant utilisation. Nous pouvons couper selon le plan du client.

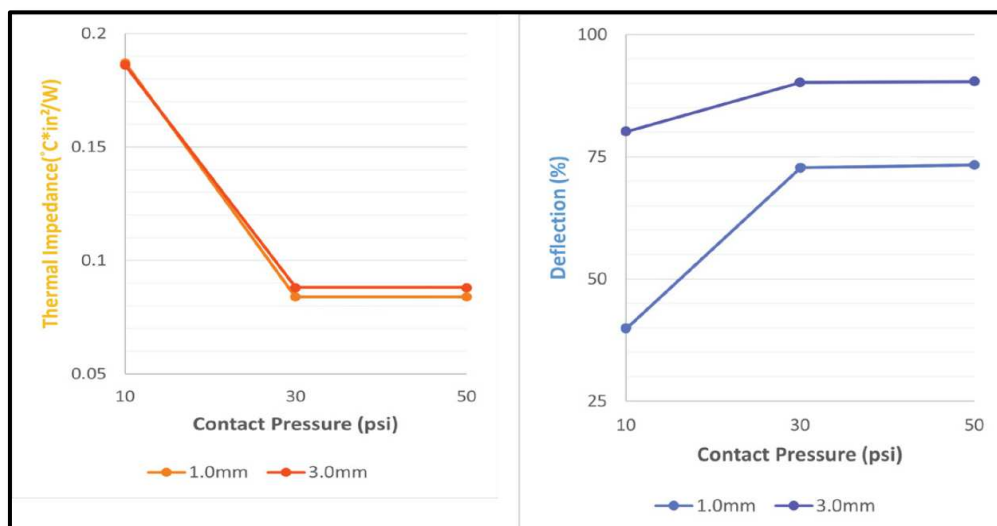


Domaines d'applications: Electronic components - Electric Vehicles, 5G, Autopilot System, Mobile Phone, AIOT, HPC (High Performance Computing), Server, IC, CPU, MOS, LED ,Mother Board, Power Supply, Heat Sink, LCD-TV, Notebook, PC, Telecom Device, Wireless Hub, DDR II Module, etc.

Caractéristiques techniques

Caractéristiques	TGF-066-AB	Unit	Tolerance	Test Method
Couleur	Vert	-	-	Colorimètre CIE 1976
Densité	3.3	g/cm ³	+/- 10%	ASTM D792
Epaisseur	0.5 - 10	mm	-	ASTM D374
Dureté	25	shore 00	+/- 10	ASTM D2240
Taille	310*310	mm	-	-
Conductivité Thermique	6.5	W/mK	+/- 10%	ASTM D5470 Modifiée
Perte de poids	< 1	%	-	ASTM E595 Modifiée
Elongation	60	%	-	ASTM D412
Tension de claquage	≥ 4	kV/mm	-	ASTM D149
Résistance volumique	10 ¹²	Ohm-m	-	ASTM D257
Certificat UL	V-0	-	-	UL 94
Température	-50 to 150	°C	-	-

Le TGF_066_AB est disponible de 0.5 à 10mm d'épaisseurs.



Les résultats ont été obtenus en conditions de laboratoire et doivent être considérés uniquement à titre indicatif. AB2E n'ayant aucun contrôle sur le matériel de ses clients et sur de nombreux autres facteurs, il relève de la responsabilité de l'utilisateur d'effectuer ses propres tests pour s'assurer que le produit correspond bien à ses besoins.

